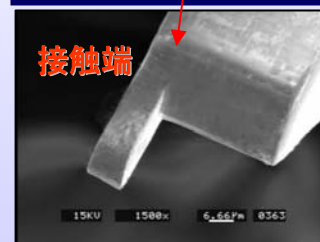
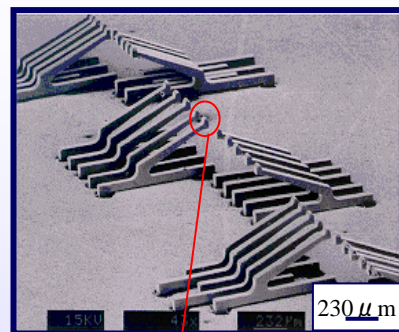
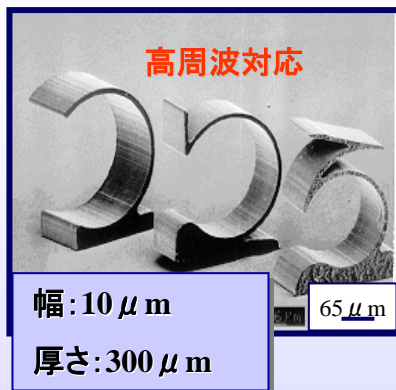
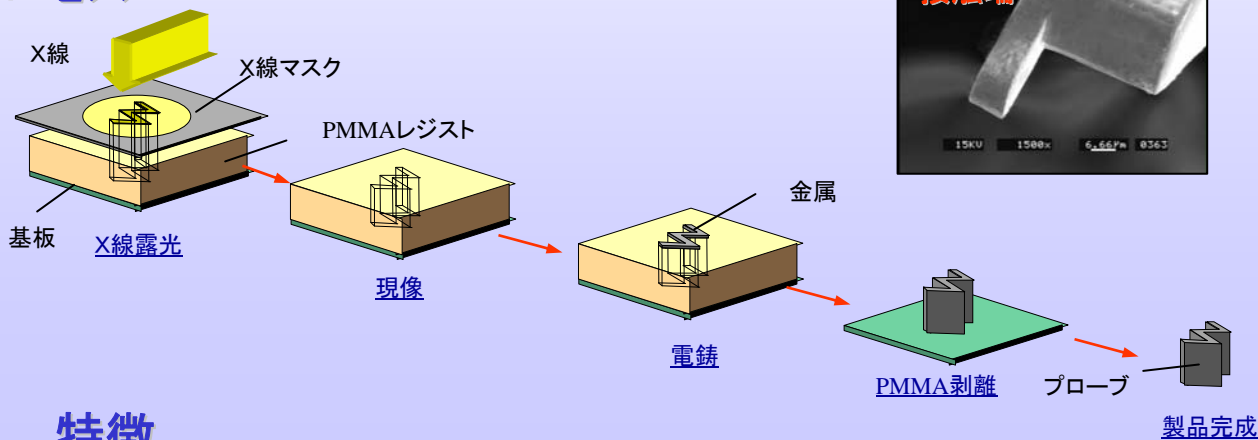


マイクロプローブ



プロセス



特徴

- ① 従来にない精度・機能を有したマイクロマシン領域の超精密プローブ。
- ② UV・X線リソグラフィと電鍍技術による製造。
- ③ 独自の特殊合金電鍍により圧延金属では得られない多様な機械・物理特性に対応。
- ④ 高周波領域に対応出来るWLBIT用マイクロプローブ。
- ⑤ マイクロマシン組み立て技術応用による実装対応の形状加工。
- ⑥ 独自の試験装置によりにより1000万回以上の耐久性を実現。

